

PG 300WT 硅片厚度测试仪

PG300WT 是由Pegasus Inc.公司最新研制开发的一款测试半导体硅片厚度的测量设备。该设备采用了高精度非接触式电容探头，可对样品进行无损及快速的厚度测量。通过触控面板控制及设定参数，设备内置软体可计算多点厚度，及5点TTV等功能。

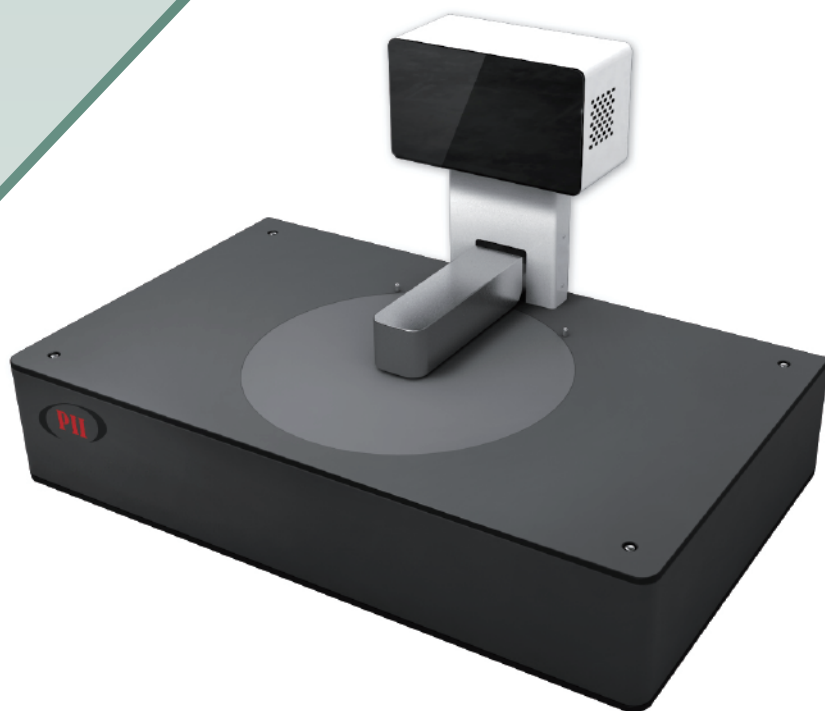
特点:

- 触控面板操作，并显示测量结果
- 可支持5点及TTV厚度测试功能
- 可支持测量硅棒切片,蚀刻片,研磨片,抛光片及带有图形的硅片
- 无需无尘室级别即可测量
- 桌上型设计,简洁且便于操作使用
可为客户定制自动上下料或多点测量方案

主要测量材料:

- 硅片 Si
- 碳化硅 SiC
- 锗 Ge
- 磷化铟 InP
- 砷化镓 GaAs
- 氮化镓 GaN

PG300WT 手动硅片厚度测试仪



设备规格

- 厚度测量范围: 300um to 1050um
- 测试样品尺寸: 75mm to 300mm
- 精度: $\pm 0.5\mu\text{m}$
- 重复性: $\pm 0.15\mu\text{m}$
- 解析度: 0.01um
- 探头测量直径: 5mm
- 操作方式: 触控屏
- 尺寸: 389mm*374mm*365mm